SEMICONDUCTOR LASER DEVICE

Patent Number:

JP8213692

Publication date:

1996-08-20

Inventor(s):

OKAI MAKOTO

Applicant(s):

HITACHI LTD

Requested Patent:

☐ JP8213692

Application (Value

Application Number: JP19950016586 19950203

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01S3/18

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To provide a semiconductor laser device using a semiconductor having hexagonal crystal system.

CONSTITUTION: A multilayer structure of epitaxial growth layers such as an N-type GaN buffer layer 2, an N-type AlGaN guide layer 3, an InGaN active layer 4, a P-type AlGaN guide layer 6, a P-type GaN clad layer 6, etc., is arranged on the (10-10) face of an Al2 O3 substrate 1 having a hexagonal crystal system, and a resonator is constituted of a cleavage plane vertical to the axis (c) of a semiconductor substrate in a semiconductor laser device. A (01-10) face, a (-1100) face or a crystal plane parallel with these either face may also be used in place of the (10-10) face.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平8-213692

(43)公開日 平成8年(1996)8月20日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

技術表示箇所

H01S 3/18

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 4 頁)

(21)出願番号

特願平7-16586

(22)出願日

平成7年(1995)2月3日

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72) 発明者 岡井 誠

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

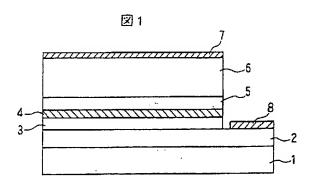
(74)代理人 弁理士 薄田 利幸

(54) 【発明の名称】 半導体レーザ装置

(57)【要約】

【目的】六方晶の結晶系を有する半導体を用いた半導体 レーザ装置を提供すること。

【構成】六方晶の結晶系を有する $A1_2O_3$ 基板1の(10-10)面上に、n型GaNパッファB2、n型A1GaNガイドB3、InGaN活性B4、p型A1GaNガイドB5、p2B40 ののでは、B40 ののでは、



2···n型 GaNバップ層 5···P型 Al GaN ガイド層 3···n型 Al GaN ガイド層 6···P型 GaN クラッド層 4···In GaN 活性層 1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 六方晶の結晶系を有する半導体基板と、該 半導体基板のc軸に平行な面の上に配置されたエピタキ シャル成長層の多層構造とからなることを特徴とする半 導体レーザ装置。

【請求項2】上記 c 軸に垂直な劈開面を有し、該劈開面 により共振器を構成したことを特徴とする請求項1記載 の半導体レーザ装置。

【請求項3】六方晶の結晶系を有する半導体基板と、該 半導体基板の(10-10)面、(01-10)面、 (-1100) 面又はそれらのいずれかに平行な結晶面 の上に配置されたエピタキシャル成長層の多層構造とか らなることを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項4】上記半導体基板の c 軸に垂直な劈開面を有 し、該劈開面により共振器を構成したことを特徴とする 請求項3記載の半導体レーザ装置。

【請求項5】上記劈開面は、(0001)面であること を特徴とする請求項2又は4記載の半導体レーザ装置。

【請求項6】上記劈開面は、その一方又は両方にコーテ 記載の半導体レーザ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、六方晶の結晶系を有す る半導体を用いた半導体レーザ装置に関する。

[0002]

【従来の技術】六方晶の結晶系を有する半導体の一例で あるGaN等は、直接遷移型バンドギャップを持ち、室 温でのバンドギャップの値から、高効率の発光デバイス が理論的に可能であると言われている。このようなGa 30 N膜を用いた発光素子として、p-n接合発光ダイオー ドが報告されている。

【0003】なお、これに関連するものとして、第24 9回蛍光体同学会講演予稿集、第31頁~第36頁(平 成6年)、ジャパニーズ ジャーナル オブ アプライ ドフィジックス, 第30巻, (1991) L1998頁 (Jpn. J. Appl. Phys., 30 (199 1) L1998) 等が挙げられる。

【0004】また、本明細書では、結晶面を表わすとき に、通常の表記に代えて、表1に示すように、数字の上 40 にパーを付けるところを、数字の前にマイナス記号を付 けて表わすものとする。

[0005]

【表1】

2 表 1

| pt 1 | |
|---------|---------|
| · | 121 |
| 通常の表記 | (1011) |
| | |
| 本明細書の表記 | (10-11) |

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上記の六方晶の結晶系 10 を有し、(0001) 面の半導体基板を用いて半導体レ ーザ装置を作製すると、レーザ共振器を形成するための 劈開面が存在せず、ファブリベローレーザ構造を構成す ることが困難であるという問題があった。

【0007】本発明の目的は、六方晶の結晶系を有する 半導体を用いた半導体レーザ装置を提供することにあ る。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明の半導体レーザ装置は、六方晶の結晶系を有 ィング膜を有することを特徴とする請求項2、4又は520する半導体基板を用い、この半導体基板のc軸に平行な 面の上にエピタキシャル成長層の多層構造を配置するよ うにしたものである。この半導体レーザ装置は、 c 軸に 垂直な劈開面を設け、劈開面により共振器を構成するこ ·とが好ましい。

> 【00009】また、上記目的を達成するために、 本発明 の半導体レーザ装置は、六方晶の結晶系を有する半導体 基板を用い、この半導体基板の(10-10)面、(0 1-10) 面、(-1100) 面又はそれらのいずれか に平行な結晶面の上にエピタキシャル成長層の多層構造 を配置するようにしたものである。この半導体レーザ装 置は、半導体基板のc軸に垂直な劈開面を設け、 劈開面 により共振器を構成することが好ましい。

> 【0010】いずれの半導体レーザ装置においても、劈 開面は(0001)面であることが好ましい。また、劈 開面の一方又は両方にコーティング膜を設けてもよい。 一方にコーティング膜を設けるときは、その反射率を7 0~90%程度とするのがよい。両方にコーティング膜 を設けるときは、その一方の反射率を上記の程度とし、 他方の反射率を 0.1~5%程度とするのがよい。この コーティング膜を設けることにより、より多くの光を取 り出すことができる。

[0011]

【作用】六方晶の結晶系の構造の模式図を図4に示す。 この結晶の c軸に垂直な (0001) 面は、劈開により 形成することができる。そこでc軸に平行な面上に、或 は、上記した(10-10)面等の結晶面にエピタキシ ャル成長層の多層構造を形成することにより、劈開面を ミラーとしたファブリベローレーザを構成することがで きる。

50 [0012]

【実施例】

〈実施例1〉本発明の第1の実施例の半導体レーザ装置 の断面模式図を図1に示す。六方晶の結晶系を有するA 12O3 基板1の(10-10)面上に、n型GaNパッ ファ層 2 (厚さ 0.2 µm)、n型A 1 G a Nガイド層 3 (厚さ0. 2 μm)、InGaN活性層4 (厚さ0. 2 μm)、p型A1GaNガイド層5 (厚さ0. 2 μ m)、p型GaNクラッド層6 (厚さ1.0μm) を有 機金属気相成長法により、順次エピタキシャル成長させ 層2の上部までエッチングし、p側電極7とn側電極8 を形成する。次に、c軸(図の左右方向)に垂直に劈開 し、劈開面である(0001)面により共振器を構成す ることにより半導体レーザ装置を製造した。

【0013】本素子の発振波長は450nm、しきい値 電流は10mAであり、室温で安定なレーザ発振を実現 した。なお、表面が(10-10)面に基板に代えて、 表面が(01-10)面、(-1100)面又はそれら のいずれかに平行な結晶面の基板を用い、同様に処理し たところ、同様な半導体レーザ装置を得ることができ 20 た。

【0014】〈実施例2〉本発明の第2の実施例の半導 体レーザ装置の断面模式図を図2に示す。六方晶の結晶 系を有するn型GaN基板11の(10-10)面に、 n型GaNバッファ層2、n型A1GaNガイド層3、 InGaN活性層4、p型AlGaNガイド層5、p型 GaNクラッド層6を有機金属気相成長法により、順次 エピタキシャル成長させ、p側電極7とn側電極8を形 成する。次に、c軸に垂直に劈開し、劈開面である(0 001)面により共振器を構成することにより半導体レ 30 式図。 ーザ装置を製造した。

【0015】本素子の発振波長は450nm、しきい値 電流は10mAであり、室温で安定なレーザ発振を実現 した。なお、表面が(10-10)面に基板に代えて、 表面が(01-10)面、(-1100)面又はそれら のいずれかに平行な結晶面の基板を用い、同様に処理し たところ、同様な半導体レーザ装置を得ることができ

【0016】 (実施例3) 本発明の第3の実施例の半導 体レーザ装置の断面模式図を図3に示す。六方晶の結晶 40 4…InGaN活性層 系を有するn型GaN基板11の(10-10)面に、 n型GaNパッファ層2、n型A1GaNガイド層3、 InGaN活性層4、p型AlGaNガイド層5、p型 GaNクラッド層6を有機金属気相成長法により、順次 エピタキシャル成長させ、p側電極7とn側電極8を形 成する。次に、c軸に垂直に劈開し、劈開面である(0 001) 面により共振器を構成する。さらに劈開面の片

端面に、SiO2からなり、反射率が2%のコーティン グ膜9、もう一方の端面に、Si/SiO2の多層膜か らなり、反射率が80%のコーティング膜10を施し、 半導体レーザ装置を製造した。

【0017】本素子の発振波長は450nm、しきい値 電流は10mAであり、室温で安定なレーザ発振を実現 した。なお、表面が(10-10)面に基板に代えて、 表面が(01-10)面、(-1100)面又はそれら のいずれかに平行な結晶面の基板を用い、同様に処理し る。エピタキシャル成長層の一部をn型GaNパッファ 10 たところ、同様な半導体レーザ装置を得ることができ た。また、コーティング膜9は形成せず、コーティング 膜10のみを設けてもよい。なお、実施例1に記載した 半導体レーザ装置に、本実施例と同様なコーティング膜 を設けることもできる。

> 【0018】以上、GaN系の半導体により構成された 半導体レーザ装置について述べてきたが、本発明は他の あらゆる六方晶の結晶系を有する半導体材料系により構 成される半導体レーザについても適応可能である。ま た、あらゆる埋め込み構造を有する半導体レーザ装置に おいても適応可能である。また、エピタキシャル成長層 の格子定数が基板のそれとずれている場合にも適応可能 である。

[0019]

【発明の効果】本発明によれば、六方晶の結晶系を有す る所望の半導体基板を用い、所望の位置にエピタキシャ ル成長層を設けることにより、半導体レーザ装置を得る ことができた。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1の半導体レーザ装置の断面模

【図2】本発明の実施例2の半導体レーザ装置の断面模

【図3】本発明の実施例3の半導体レーザ装置の断面模 式図。

【図4】 六方晶の結晶構造を示す図 【符号の説明】

1 ··· A 1 2 O 3 基板

2…n型GaNパッファ層

3…n型A1GaNガイド層

5…p型A I G a Nガイド層

6…p型GaNクラッド層

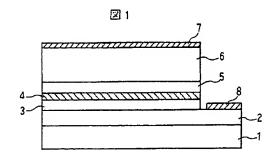
7…p側電極

8…n側電極

9、10…コーティング膜

11…n型GaN基板

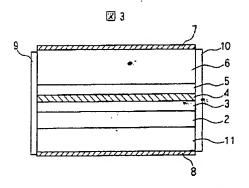
[図1]



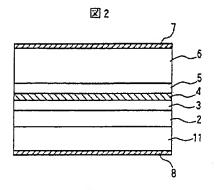
2…n型 GaNパップタ層 5…P型Al GaNガイド層 3…n型 Al GaNガイド層 6…P型GaNクラッド層

4…InGaN 活性層

[図3]



2…n型GaNバッファ層 5…P型AlGaNガイド層 3…n型AlGaNガイド層 6…P型GaNクラッド層 4…InGaN活性層 9.10…コーティング 膜 【図2】



2···n型GaNバッカ層 · 5···P型AlGaNガイド層 3···n型AlGaNガイド層 6···P型GaNクラッド層 4···InGaN活性層

【図4】

図4

